

公司簡介

一、 設立日期：民國 71 年 9 月 13 日

二、 公司沿革：

本公司創立於民國七十一年九月十三日，創立時公司名稱為漢唐科技工程有限公司，創立時資本額為新台幣 510 萬元，從事輸配電、電機、電器、電腦及通信設備之施工安裝。

基於精益求精追求盡善盡美的經營理念，在短短數年內已成為當時國內第一名的電腦機房工程專業廠商，不論在業績上及專業技術上都有顯著的成果，業務範圍也逐漸擴大到大型的水電空調及建廠工程上，也在這些大型的個案上建立了負責任、服務到底及專業品質的良好形象，業務不斷擴充，至民國七十九年三月更名為漢唐訊聯股份有限公司，並於同年十一月完成與訊聯系統股份有限公司之合併程序，成為國內唯一在大型機電、無塵室、電腦、通信、控制系統整合的現代化綜合性科技系統整合公司，憑藉著崇本務實的經營團隊，完善的組織規劃及充沛的專業人才配置，使本公司之業務日益開展，在國內半導體建廠之全廠整合，及國內的電腦通信及控制系統整合工程上，目前已成為首屈一指的專業公司。

本公司係依技術與專業為基礎來發展的，標榜的是第一流的技術與服務到底的精神，十餘年來已奠定了良好的經營基礎，員工人數目前已超過八百多人，大部份係各相關領域的專業技術人才。民國九十一年五月更名為漢唐集成股份有限公司，民國九十二年七月合併台群科技股份有限公司，資本額目前為新台幣壹拾玖億伍佰捌拾陸萬陸仟玖佰捌拾元，年合併營業額達新台幣達 256 億 6 佰餘萬元，並維持穩定的獲利能力，目前公司正穩健的朝向更遠大的營運目標發展中。

1. 本公司歷年重要記事如下：

- 71 年 9 月：原漢唐科技工程有限公司成立，資本額新台幣 510 萬元，成立初期以從事電腦機房工程業務為主。
- 73 年 4 月：購置台北市南京東路四段辦公室。
- 74 年 8 月：增資新台幣 1,000 萬元，資本額為新台幣 1,510 萬元，以充實營業資金。
- 76 年 8 月：增資新台幣 4,000 萬元，資本額為新台幣 5,510 萬元，以支應業務擴大之需求。
- 77 年 7 月：增資新台幣 3,000 萬元，資本額為新台幣 8,510 萬元，增加冷凍空調工程及交通系統工程、大樓、工廠及環境監控系統工程等業務。

- 77 年 11 月：購置高雄辦事處辦公室，以擴展南部地區之業務及服務。
- 78 年 9 月：與華邦電子公司簽訂 VLSI 一廠水電空調工程合約，為本公司在半導體廠建廠工程上首次之較大型合約；其後並陸續與科學園區內旺宏電子、德基半導體、台灣積體電路等半導體廠簽訂建廠相關合約，奠定本公司日後在半導體業整廠整合之良好基礎。
- 78 年 12 月：購置新店寶高路辦公室一樓。
- 79 年 3 月：公司更名為漢唐訊聯股份有限公司。
- 79 年 7 月：購置台北市復興北路辦公室，並為業務部門營業地址。
- 79 年 11 月：購置新店寶高路辦公室五樓。
- 79 年 11 月：合併訊聯系統股份有限公司，公司資本額增加至新台幣 14,060 萬元，營業範圍擴充至大型機電工程及系統整合工程；在系統整合服務上，結合兩家公司之專長與實力，獲得了更進一步的發展實力。
- 80 年 7 月：與華邦電子公司簽訂半導體二廠新建工程水電空調控制及附屬設備工程合約，為本公司承建半導體廠歷年來最大之工程。
- 80 年 8 月：與台灣省政府住都局簽訂八里污水廠第一期新建工程儀錶控制系統合約，為國內廠商自行承建最大之儀控系統工程，奠定本公司在大型儀控系統方面之設計施工能力。
- 80 年 8 月：與交通部地下鐵工程處簽訂台北市區鐵路地下化工程松延計劃電信工程合約，為首次由國內廠商自力承建之隧道通信工程。
- 80 年 11 月：增資新台幣參仟零肆拾萬元，公司資本額為新台幣壹億柒仟壹佰萬元。
- 82 年 8 月：與交通部高速公路局簽訂汐止五股高架拓寬段交通控制系統合約，為首次由國內廠商自力承建之大型交控系統工程。
- 83 年 4 月：與台灣積體電路公司簽訂新建三廠機電系統整合合約，為本公司承接半導體建廠工程歷年來最大個案。
- 83 年 9 月：購買朝明科技股份有限公司產品及設備，擴大產品事業規模，增加不斷電系統設備國內外市場之銷售。
- 84 年 3 月：購置新店寶高路 7 巷 1 號 1 樓，增建新店寶高路生產廠完成，擴大 UPS 生產能量至每年六億元台幣。
- 84 年 3 月：與臺灣省煙酒公賣局簽訂嘉義酒廠二期工程之儀控系統工程，為本公司在大型儀控系統方面能力之再度展現。
- 84 年 5 月：經證管會核准現金及盈餘轉增資並核准為公開發行公司。

- 84 年 5 月：與中國商銀簽訂其福州街資訊大樓水電及電腦連線系統合約，是本公司承攬銀行界水電工程最大個案。
- 84 年 8 月：完成現金及盈餘轉增資計二億五千一百三十萬元，公司資本額因之增加至四億二千二百三十萬元。
- 84 年 11 月：與宏碁營造股份有限公司簽訂力晶半導體廠水電消防工程，為本公司再度與外商公司合作之個案。
- 85 年 1 月：與臺灣積體電路公司因三廠合作之成功經驗再度簽定四廠之水電空調工程，足見本公司榮獲客戶信賴之程度。
- 85 年 1 月：與日商高砂公司再度合作簽訂華邦電子公司 CUB 工程，也可見本公司服務及能力亦備受外商公司之肯定。
- 85 年 1 月：與旺宏電子公司也因延續以往愉快之合作經驗再度簽訂其二廠中央空調工程。
- 85 年 2 月：與和喬科技股份有限公司簽訂無塵室興建工程，為國內公司獨力興建無塵室跨入新紀元。
- 85 年 4 月：再與和喬科技股份有限公司簽訂第二期無塵室興建工程。
- 85 年 6 月：同時與和喬科技股份有限公司簽訂興建無塵室之水電空調暨全區系統整合工程。
- 85 年 8 月：與東元電機股份有限公司簽訂台灣信越半導體廠房興建工程。
- 85 年 8 月：與華邦再次簽訂四廠水電空調工程。
- 85 年 9 月：完成盈餘轉增資，公司資本額增加五億零六百七拾六萬元。
- 86 年 3 月：基於台灣電信業蓬勃發展，本公司亦不落人後，投入大哥大基地台興建，已接獲電信基地台工程金額約為四億元。
- 86 年 4 月：與旺宏再次簽訂總部大樓地下層 MEP 工程。
- 86 年 5 月：與天下再簽訂 AMPI 無塵室新建工程。
- 86 年 5 月：完成盈餘轉增資，公司資本額增加至六億零八百一拾一萬一仟一佰萬元。
- 86 年 8 月：與華氣社（股）簽訂 BP-8, BP-9 機電工程。
- 86 年 9 月：與世大積體電路股份有限公司簽訂新建八吋晶圓片 CUB、MEP1 及 MEP2 機電設備之安裝工程，並且與華新機電股份有限公司合作完成合約。
- 86 年 9 月：與立生半導體(股)簽訂廠房新建工程。
- 87 年 1 月：與旺宏電子(股)簽訂旺宏總部大樓新建工程。
- 87 年 2 月：公司股票正式在櫃檯買賣中心掛牌交易。
- 87 年 3 月：與達基科技(股)簽訂第二期水電空調新建工程。

- 87 年 5 月：與台灣積體電路股份有限公司簽訂台南科學園區台積六廠新建工程。
- 87 年 5 月：完成盈餘及員工紅利轉增資，公司資本額增加至柒億陸仟玖佰貳拾玖萬柒仟肆佰貳拾元。
- 87 年 6 月：產品事業部正式獨立成為子公司豫順電子股份有限公司。
- 87 年 8 月：完成現金增資，公司資本額增加至捌億玖仟玖佰貳拾玖萬柒仟肆佰貳拾元。
- 87 年 10 月：與奇美電子股份有限公司簽訂奇美電子無塵室新建工程。
- 87 年 12 月：與華特電子股份有限公司簽訂華特三廠新建工程。
- 88 年 2 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂 FAB 工廠無塵室及全廠機電電腦監控系統整合工程。
- 88 年 12 月：與大陸工程（股）簽訂台北都會捷運系統工程 CD 550 標工程（水電、環控工程）。
- 88 年 12 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂 FAB II 廠新建工程。
- 89 年 2 月：與達基科技（股）簽訂龍潭二廠大 MEP 工程。
- 89 年 2 月：與大陸工程（股）簽訂台北都會捷運系統工程 CD 550 標工程（水電、環控工程除外）。
- 89 年 3 月：與廣輝電子（股）簽訂廣輝林口興建廠房無塵室新建工程。
- 89 年 4 月：臺灣證券交易所上市掛牌
- 89 年 8 月：與全球聯合通信〈股〉簽訂無塵室新建工程。
- 89 年 9 月：與數位聯合電信〈股〉簽訂內湖機房新建工程。
- 89 年 9 月：與台積電〈股〉簽訂 TSMC FAB12 MEP 工程。
- 89 年 10 月：與台積電〈股〉簽訂 TSMC FAB14 MEP 工程。
- 89 年 11 月：與台積電〈股〉簽訂 TSMC 14 廠無塵室工程。
- 90 年 2 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂 FAB II 設計變更追加工程。
- 90 年 2 月：與高平磊晶科技（股）簽訂廠房新建機電工程。
- 90 年 5 月：與旺宏電子（股）簽訂 MXIC FAB3 MEP PROJECT 工程。
- 90 年 8 月：與漢磊科技（股）簽訂廠房機電及無塵室工程。
- 90 年 10 月：與宏力半導體製造（股）簽訂上海廠房新建工程。
- 90 年 12 月：與台積電（股）簽訂 F12 MEP FOR OFFICE 1-6F 工程。

- 90 年 12 月：與大陸工程（股）簽訂台北都會捷運系統工程 CD 315 標通訊系統工程。
- 91 年 3 月：與廣輝電子（股）簽訂二廠新建工程。
- 91 年 4 月：與台積電（股）簽訂台積 14 ME 工程。
- 91 年 7 月：與友達光電（股）簽訂友達光電 LCA 廠房新建工程。
- 91 年 7 月：與友達光電（股）簽訂 CATPROJECT 工程。
- 91 年 8 月：與台積電（股）簽訂 TSMC FAB12 MEP 擴充工程。
- 91 年 8 月：與台積電（股）簽訂 TSMC12 H/Q MEP&OFFICE MEP7-9F 工程。
- 91 年 9 月：與奇美電子（股）簽訂 FAB3 CF C/R 工程。
- 91 年 10 月：與友達光電（蘇州）簽訂 FAB I CELL 廠新建工程。
- 91 年 11 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂彩晶 FAB III 第一期無塵室統包工程。
- 91 年 11 月：與廣輝電子（股）簽訂 LINE III UTILITY 包需求變更工程。
- 91 年 11 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂彩晶 FAB III MEP 工程。
- 92 年 3 月：與瀚宇彩晶（股）簽訂彩晶 FAB III 30K HOOK UP 工程。
- 92 年 3 月：與中強光電（股）簽訂中強光電竹南廠二期工程。
- 92 年 4 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 無塵室工程。
- 92 年 6 月：與台灣積電(股)簽訂 TSM12 SUPPORT 1F C/R 工程。
- 92 年 8 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 工程。
- 92 年 8 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 工程。
- 92 年 11 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 C/R CELL A LINE 工程。
- 92 年 11 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠南京瀚宇彩欣 FAB III 工程。
- 92 年 12 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 PHASE II HOOK UP 工程。
- 92 年 12 月：與台灣積電(股)簽訂 TSM14 HOOK UP3K Turn-key Package 工程。
- 93 年 1 月：與廣輝電子（股）簽訂達偉 QDS LCM Fab F3 project 工程。
- 93 年 1 月：與奇美電子（股）簽訂 FAB4 廠 LCD/CR 工程。
- 93 年 1 月：與友達光電（股）簽訂 Tango project M10 C/R 工程。
- 93 年 2 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 FAB3 PHASE III 工程。

- 93 年 3 月：與廣輝電子(股)簽訂 QDI' s TFT-LCD Fab Line3 Project 工程。
- 93 年 7 月：與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB IV TFT-LCD 新建工程。
- 93 年 7 月：與茂德科技(股)簽訂中科廠 FAB III MEP 工程。
- 93 年 9 月：與友達光電(股)簽訂台中廠一期 Lephant project 工程。
- 93 年 9 月：與廣輝電子(股)簽訂 QDI LINEII 75K 擴充工程。
- 93 年 12 月：與華邦電子(股)簽訂中科廠無塵室工程
- 94 年 1 月：與台塑石化(股)簽訂台塑六輕煉油廠南北儀電統包工程。
- 94 年 3 月：與宏茂微電子(上海)有限公司簽訂宏茂微電子(上海)新建廠房機電裝修工程。
- 94 年 10 月：與奇美電子(股)簽訂五廠 CLEAN ROOM PACKAGE 工程。
- 94 年 11 月：與南茂科技(股)簽訂竹北廠 1.2.4F 機電空調及裝修工程。
- 94 年 12 月：與南茂科技(股)簽訂南茂科技南科廠 T-B 棟新建工程。
- 95 年 1 月：與友達光電(股)簽訂友達台中 B11 無塵室工程。
- 95 年 2 月：與奇美電子(股)簽訂 CMO CLEANROOM PROJECT(1+2 期)工程。
- 95 年 4 月：與力晶半導體(股)簽訂力晶 FAB 12M C/R 改建工程。
- 95 年 5 月：與台積電(股)簽訂 FAB14 41K HOOK UP ENGINEERING 工程。
- 95 年 5 月：與台積電(股)簽訂 TAMC12 PHASE 3B PROJECT 工程。
- 95 年 6 月：與南茂科技(股)簽訂 T-B 棟機電工程。
- 95 年 8 月：與茂德科技(股)簽訂茂德 FAB14 MEP M10 機電工程。
- 95 年 10 月：與奇美電子(股)簽訂 CMO FAB6 無塵室工程。
- 95 年 10 月：與力晶半導體(股)簽訂 PSC 12C 無塵室工程。
- 95 年 10 月：與台積電(股)簽訂 FAB14 P3 MEP+FP PACKAGE 工程。
- 96 年 1 月：與南茂科技(股)簽訂無塵室機電工程。
- 96 年 2 月：與南茂科技(股)簽訂南茂科技竹北廠 4F 無塵室擴建工程
- 96 年 4 月：與台積電(股)簽訂 F14 P2 61.3K HOOK UP 工程。
- 96 年 7 月：與健鼎電子(無錫)(有)簽訂健鼎 PCB 五廠無塵室空調製程工程。
- 96 年 7 月：與瑞晶電子(股)簽訂瑞晶 R1 廠 PHASE II 動力幹線工程。
- 96 年 8 月：與華邦電子(股)簽訂華邦 FAB6 B 無塵室新建工程。
- 96 年 8 月：與瑞晶電子(股)簽訂 FAB R1 PHASE II 無塵室工程。

- 96 年 8 月：與台積電(上海) (有)簽訂台積 F10 P2 MEP PACKAGE 工程。
- 96 年 9 月：與深超光電(股)簽訂深超深圳模組一廠淨化室系統工程。
- 96 年 12 月：與龍騰光電(有)簽訂龍騰光電 110K 擴建主系統工程。
- 97 年 1 月：與台積電(股)簽訂 F14 P2 HOOK UP 工程。
- 97 年 1 月：與祈中科(蘇洲)(有)簽訂水電空調及廠務系統管路工程。
- 97 年 2 月：與深超(深圳)(有)簽訂模組一廠淨化系統-H1 工程。
- 97 年 3 月：與深超(深圳)(有)簽訂一般電力工程。
- 97 年 3 月：與友達光電(股)簽訂友達台中廠 M12 無塵室工程。
- 97 年 3 月：與群創光電(股)簽訂 T2 C/F 無塵室工程。
- 97 年 3 月：與友達光電(股)簽訂友達新竹 DAWN 廠房新建機電工程。
- 97 年 4 月：與台積電(股)簽訂 F12 P4 - MEP、FP、C/R, VE 工程。
- 97 年 5 月：與深超(深圳)(有)簽訂 K 1 區工藝生產設備管道工程。
- 97 年 5 月：與台積電(股)簽訂 F12 P4 -PX PACKAGE 工程。
- 97 年 7 月：與江蘇百世德(有)簽訂薄膜太陽電池生產項目工程。
- 97 年 7 月：與大同(股)簽訂華映 L2 UP 120K 專案 C/R 修改工程。
- 97 年 8 月：與瑞晶(股)簽訂 FAB R2 PCW、C/R、CHILLER PLANT 及 R2 動力幹線工程。
- 97 年 10 月：「非接觸式乾眼症檢測儀」獲得經濟部 97 年度「產業創新成果表揚獎」。
- 98 年 06 月：與福聚太陽能(股)簽訂福聚 PSS PROJECT C/R 工程。
- 98 年 06 月：與華亞半導體(股)簽訂華亞堆疊製程 HOOK UP 工程。
- 98 年 08 月：與友達光電(股)簽訂友達 AUO 七星廠區動力 MEP 工程。
- 98 年 09 月：與友達光電(股)簽訂友達 L8B MEP 工程。
- 98 年 09 月：與台積電(股)簽訂 F12 P4 MEP C/R ELE PACKAGE STAGE 2 工程。
- 98 年 12 月：與台積電(股)簽訂 F14 AY CODE N65 82 台新裝機工程。
- 98 年 12 月：與友達光電(股)簽訂友達 L8B 新建廠房 M&E 工程。
- 99 年 1 月 台灣積體電路製造(股)簽訂 TSMC FAB 12 P5 工程
- 99 年 1 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 P3 2010 N4&N65 HOOK UP 工程
- 99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 P4 LEAROOM&CAS PACKAGE 工程

- 99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 MEP&FIRE PROTECTION&PX PACKAGE 工程
- 99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P4 PX PACKAGE 工程
- 99 年 5 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 N65 BK CODE 103 台新裝機工程
- 99 年 6 月 南茂科技(股) 簽訂南茂 TB 棟 3 樓 C/R 擴建及 TA 棟 2 樓 C/R 擴建
- 99 年 8 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC 12 P5 EBO 工程
- 99 年 8 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC 12 P2 HPM B1F CR 新建工程
- 99 年 8 月 南茂科技(股) 簽訂南茂竹北廠五樓擴建工程
- 99 年 10 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F15 P1 MEP&PX PACKAGE 工程
- 99 年 10 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P4 HOOK UP 180 工程
- 99 年 11 月 台灣積體電路製造(股) TSMC SOLAR PROJECT PHASE 1 MEP PACKAGE 工程
- 99 年 12 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F15P1 C/R WBS 工程
- 100 年 01 月 友達光電(股)友達新加坡 L4B CLEANROOM EXPANSION
- 100 年 01 月 高通顯示器製造(股)通廠房新建工程
- 100 年 02 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 P3 OFFICE 3F WAT C/R 工程
- 100 年 02 月 友達光電(股)友達 GRC MEP 工程
- 100 年 03 月 友達晶材(股)友達晶材台中港加工出口區一期廠房機電工程
- 100 年 04 月 友達晶材中港 C/R 新建工程
- 100 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 MEP
- 100 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 CLEANROOM SYSTEM
- 100 年 9 月 註銷庫藏股減資新台幣參仟伍佰捌拾玖萬元，公司實收資本額為新台幣貳拾肆億柒仟肆佰捌拾參萬參仟柒佰參拾元。
- 100 年 11 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P6 C/R PACKAGE STAGE-1
- 100 年 12 月 註銷庫藏股減資新台幣玖仟貳佰伍拾萬元，公司實收資本額為新台幣貳拾參億捌仟貳佰參拾參萬參仟柒佰參拾元。
- 101 年 03 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F12 P6 C/R STAGE-2
- 101 年 03 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 LAYOUT 工程

- 101 年 04 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P3 MEP 工程
- 101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P3 CLEANROOM 工程
- 101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F6 BUMPPING 工程
- 101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)F12 P6 CCD EXPANSION-EDC2 F12 P4 SITE 工程
- 101 年 06 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F12 P6 CCD EXPANSION-F8 DC1 工程
- 101 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 OFFICE TESTING CLEANROOM AND UTILITY PACKAGE 工程
- 101 年 09 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P4 MEP 工程一期
- 101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 P5 MEP PACKAGE 工程
- 101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P4 CLEANROOM 工程
- 101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC FAB14 P5 FAB ARER CLEAR ROOM 工程
- 102 年 01 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 POWER HOOK UP 工程
- 102 年 01 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F4 HOOK UP 工程 EXHAUST, CAP, FILTER 工程
- 102 年 03 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 PX PACKAGE 工程
- 102 年 04 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 MEP PACKAGE 工程
- 102 年 04 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 CLEAM ROOMO PACKAGE 工程
- 102 年 11 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 POWER HOOK UP 廠務追加工程
- 102 年 8 月 環維電子(上海)(有)生產廠房 1&2F 無塵室&內裝工程
- 102 年 10 月 南京中電熊貓液晶顯示科技(有)新增淨房系統改進工程(+10K) 工程
- 102 年 09 月 環維電子(上海)(有)生產廠房 3F 新建無塵室工程
- 103 年 01 月 台灣美光 R2 25NM 75K CLEANROOM 工程(STANGE 1+2)
- 103 年 01 月 TSMC F14 OFFIC TESTING C/R AND UTILITY PACKAGE
- 103 年 02 月 TSMC 精材科技新廠廠區機電及潔淨室安裝工程
- 103 年 04 月 TSMC F14 P7 C/R
- 103 年 06 月 新加坡友達 L4B POWER MTM project
- 103 年 09 月 南茂 TB 棟 4F 改建無塵室
- 103 年 10 月 TSMC F12 P7 MEP PACKAGE

- 103 年 11 月 友達光電 L8B B21 P1 P2 P3 無塵室擴充工程
- 103 年 11 月 TSMC F12 P7 CLEAN ROOM PACKAGE
- 104 年 02 月 日月光半導體製造(股)公司高雄廠 K22 平面建廠新建工程
- 104 年 02 月 台灣美光 FAB A2 Base Build Project
- 105 年 01 月 華邦電子 MEP+CR
- 105 年 02 月 TSMC F15 P6 MEP PACKAGE STAGE 1 (EQUIPMENT/LABOR/MATERIAL)
- 105 年 03 月 TSMC F15 P5 MEP PACKAGE (STAGE 1) (UPS)
- 105 年 03 月 TSMC F15 P6 CR SCAD-TEM-組頭間追加工程
- 105 年 10 月 台灣美光 A2 110S TOTAL GAS SYSTEM(MOR)
- 105 年 11 月 台積電南京 CHINA CLEANROOM PACKAGE-EQ (STAGE 1)
- 106 年 03 月 台積電 TSMC F-12 P4 EUV MEP+CR 工程
- 106 年 10 月 SSMC Expansion project
- 106 年 11 月 台灣美光-TCP 廠房新建工程
- 107 年 02 月 SSMC 廠房新建工程—設備採購
- 107 年 02 月 台灣美光 F11 CUB-1B 新建工程
- 107 年 04 月 TSMC F15P7 C/R PROJECT A
- 107 年 04 月 TSMC F18 P1 MEP-A PACKAGE
- 107 年 04 月 TSMC F18 P1 MEP-B PACKAGE
- 107 年 04 月 TSMC F18 P1 FIRE PACKAGE
- 107 年 05 月 TSMC F18 P1 C/R
- 107 年 06 月 長江存儲國家存儲器基地目(一期)工設備管線進口設備
- 107 年 07 月 台灣美光 Build up for MTB warehouse
- 107 年 07 月 台灣美光 A2 E100 expansion project
- 107 年 07 月 台灣福雷—日月光 k22 6F TEST 建廠工程
- 107 年 07 月 TSMC-F18P1 EBO 工程
- 107 年 08 月 高平磊晶 3F 廠房新建 TURN-KEY 工程
- 107 年 12 月 減資新台幣肆億柒仟陸佰肆拾陸萬陸仟柒佰伍拾元，公司資本額為新台幣壹拾玖億伍佰捌拾陸萬陸仟玖佰捌拾元。
- 107 年 12 月 友達光電華亞廠 L3D IJP 專案

- 107 年 12 月 TSMC F18 P2 MEP-A PACKAGE
- 107 年 12 月 TSMC F18 P2 MEP-B PACKAGE
- 107 年 12 月 TSMC F18 P2 FIRE PACKAGE
- 107 年 12 月 TSMC F18 P2 PCW PACKAGE
- 107 年 12 月 TSMC F18 P2 C/R PACKAGE
- 108 年 02 月 宏捷 二期廠房擴建工程(甲,乙,丙,丁,戊,己棟)-機電發包工程
- 108 年 03 月 台灣美光后里新建廠房整體設計案
- 108 年 07 月 TSMC F15P7 C/R Project B
- 108 年 07 月 TSMC F15 P7 MEP PACKAGE B
- 108 年 10 月 TSMC F18 P3 MEP A PACKAGE
- 108 年 10 月 TSMC F18 P3 MEP B PACKAGE
- 108 年 10 月 TSMC F18 P3 FIRE PACKAGE
- 108 年 11 月 TSMC F18 P3 C/R
- 109 年 01 月 長江存儲(一期)二階工程項目工藝設備管線購裝 B 標段-進口設備
- 109 年 01 月 TSMC F18 P3 EBO CR PACKAGE
- 109 年 04 月 宏捷 二期擴建工程 新增無塵室各系統
- 109 年 04 月 台灣美光 f16 tool install service po-Gas/NG/BA
- 109 年 06 月 TSMC F18 P4 MEP PACKAGE
- 109 年 06 月 TSMC F18 P4 CLEAN ROOM PACKAGE
- 109 年 10 月 TSMC F18 P4 CLEAN ROOM PACKAGE
- 109 年 11 月 TSMC RDR1 C/R
- 109 年 11 月 TSMC F18 P5 CLEANROOM PACKAGE
- 110 年 01 月 購置新北市中和區橋和路台灣科技廣場辦公室 13 樓
- 110 年 01 月 宏捷 二期擴建工程_2F 無塵室增建工程
- 110 年 02 月 TSMC F18 P6 MEP PACKAGE
- 110 年 03 月 TSMC F18 P6 C/R
- 110 年 04 月 購置台中市西屯區安和東路 168 號辦公室
- 110 年 04 月 TSMC 12B-BRIDGE_SP1_F12 P7 CR RETROFIT
- 110 年 07 月 TSMC F21 AAS Project
- 110 年 07 月 TSMC F21 CLEANROOM
- 110 年 07 月 TSMC F21 MEP

- 110 年 11 月 TSMC TCZWM MEP PACKAGE
- 110 年 11 月 TSMC F18 P7 MEP A
- 110 年 11 月 TSMC F18 P7 CLEAR ROOM A
- 110 年 12 月 TSMC F14 P8 MEP STAGE-1